

Title (en)

Manufacturing process of a hollow composite insulator

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines hohlen Verbundisolators

Title (fr)

Procédé de fabrication d'un isolateur composite creux

Publication

EP 1091365 A1 20010411 (DE)

Application

EP 99119832 A 19991007

Priority

EP 99119832 A 19991007

Abstract (en)

The method for producing a hollow compound insulator (1) for medium and high voltages involves formation of a screening (5) of HTV (high temperature vulcanizing) silicone rubber around a plastic pipe (2) by injection molding. At least a section of the plastic pipe is supported against the pressure of the silicone rubber material at least during a part of the injection molding process. Also claimed is a resultant hollow compound insulator.

Abstract (de)

Zur Herstellung eines Verbundisolators (1) wird dessen mit Flanschen (3, 4) versehenes Kunststoffrohr (2) in eine Spritzgussform (8) eingebracht. Der Hohlraum (9) der Spritzgussform entspricht dabei in seiner Gestalt der aufzubringenden Beschirmung aus Silikonkautschukmaterial. Es wird eine Beschirmung aus HTV-Silikonkautschukmaterial durch Spritzguss aufgebracht, wobei das Kunststoffrohr (2) durch ein eingeschobenes Metallrohr (10) während des Spritzgussverfahrens abgestützt wird. Dies erlaubt die Einbringung von HTV-Material unter hohem Druck und mit hoher Temperatur, ohne Gefahr der Beschädigung des Kunststoffrohres. Das HTV-Material hat den Vorteil, dass es sehr schnell vulkanisiert, was ein rasches Entformen des Isolators (1) und die unmittelbare erneute Verwendung der Form erlaubt. <IMAGE>

IPC 1-7

H01B 19/00; **H01B 17/42**

IPC 8 full level

H01B 17/32 (2006.01); **H01B 19/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01B 17/32 (2013.01); **H01B 19/00** (2013.01)

Citation (search report)

- [A] DE 19738338 A1 19980312 - NGK INSULATORS LTD [JP]
- [A] DE 2643197 B1 19771124 - SIEMENS AG
- [A] DE 29609229 U1 19960814 - CELLPACK AG [CH]

Cited by

DE102010050684A1; US9601240B2; WO2020043452A1; CN107014692A; CN109698049A; CN112117067A; DE102014004284A1; DE102014004284B4; DE102010050684B4; US2013025912A1; DE102010015729B4; WO2017108141A1; WO2012059198A1; DE102016217621A1; WO2018050436A1; DE102011088248A1; WO2013087414A1; US9236164B2; EP3394863A1; US7989704B2; WO2011131273A1; DE102010015729A1; US11114220B2; US11636960B2; EP1667175B1; EP2791948B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 1091365 A1 20010411; **EP 1091365 B1 20051026**; AT E308106 T1 20051115; DE 59912714 D1 20051201

DOCDB simple family (application)

EP 99119832 A 19991007; AT 99119832 T 19991007; DE 59912714 T 19991007